

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2026-015

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准），该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准），申请授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述授信额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，授信额度在有效期限内可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保、融资租赁等相关申请书、合同、协议书等文件，抵质押、担保资产包括但不限于自有资产），并根据公司实际的融资需求在各国内银行、外资银行及非银金融机构等金

融机构及非金融机构间进行分配。

二、 备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月22日